

25G全预置焊锡一体式共晶设备

外观和主要功能获专利保护



创新点：

技术一；芯片拾取焊接系统

技术二；高精度芯片快速定位装置

技术三；蓝膜分离取晶装置

技术四；视觉定位共晶焊接装置

技术指示：

直线电机； X、Y、重复精度1 μ m、R1°

焊接吸嘴； 20g---80g压力传感监控

共晶焊台； 常温—400度、曲线控制焊接

UPH 值； 200 / PCS

品质精度： $\leq \pm 5\mu\text{m}$,角度 $\pm 1^\circ$

主件 移动； 光标定位 \ 线性电机

芯片定位； 重心检测 \ 图像识别

运行软件； 模块化控制 / 惯量定位

知识产权： 发明3项、外观1项、实用新型15项、
软件著作权1项

焊接示意图：

底座、上锡
热沉、管脚
上锡、芯片



创新点：

技术一；芯片拾取焊接系统

技术二；高精度芯片快速定位装置

技术三；蓝膜分离取晶装置

技术四；视觉定位共晶焊接装置

技术指示：

直线电机； X、Y、重复精度1 μ m、R1°

焊接吸嘴； 20g---80g压力传感监控

共晶焊台； 常温—400度、曲线控制焊接

UPH 值； 200 / PCS

品质精度： $\leq \pm 5\mu\text{m}$,角度 $\pm 1^\circ$

主件 移动； 光标定位 \ 线性电机

芯片定位； 重心检测 \ 图像识别

运行软件； 模块化控制 / 惯量定位

知识产权： 发明3项、外观1项、实用新型15项、
软件著作权1项